【B-３】AI

（敬称略）

11 月 1 日(金) 15:15-17:30

セッションチェアマン： 加藤 千晴(㈱村田製作所)

◆ アダプティブ AI について(仮題)

株式会社レベリング
代表取締役社長
柳谷 智宣

[講演要旨]

[講演者プロファイル]

◆ 組み込み AI の技術動向と電力効率 10 倍を実現する

ルネサスの AI アクセラレータ(DRP-AI)の御紹介

ルネサスエレクトロニクス株式会社
エンベデッドプロセッシングプロダクトグループ
エンベデッドプロセッシング第一事業部
主管技師
野澤 浩一

[講演要旨]

近年、カメラやロボット等の装置内に AI を組み込み、リアルタイムな環境認識や動作フィードバックを可能にする組み込み AI システムの需要が高まっています。この市場に向けて、ルネサスは高い電力効率を特徴とする独自の AI アクセラレータ（DRP-AI）を搭載した AI-MPU(RZ/V シリーズ)を展開しています。本講演では、組み込み AI のハードウェア技術動向を俯瞰するとともに、DRP-AI の特徴や最新の AI-MPU 製品である RZ/V2H の応用事例を紹介します。

[講演者プロファイル]

2002 年 東京大学工学系研究科 博士課程を修了。 NEC に入社し、スーパーコンピュータ向けの高信頼回路設計技術などを担当。2010 年にルネサスエレクトロニクスへ移籍後は、マイコン・SoC の低電力回路設計に従事。現在は AI 向けマイクロプロセッサのハードウェア・ソフトウェア技術マネジメントを担

当。

◆ エッジ AI の社会実装における現実と可能性

株式会社村田製作所
通信モジュール事業部 コネクティビティモジュール開発部
戦略企画室 マネージャー
飯塚 雄彦

[講演要旨]

本講演では、エッジ AI 領域における急速な技術発展と社会実装の隔たりに焦点を当てます。村田製作所でエッジ AI モジュールの開発や拡販活動を行ってきた経験を元に、「技術的にできること」と「現場で使えること」の隔たりを言語化したうえで、そこを打開し社会実装を加速させる切り口について講演します。

[講演者プロファイル]

2012 年より村田製作所入社し、CAE 技術開発に 5 年、通信モジュールのハードウェア開発に 3 年ほど従事。

2020 年よりモジュール事業部の戦略企画課として、主にエッジ AI 技術を軸とした事業開発を担う。

2022 年にはエッジ AI モジュールで CEATEC AWARD（キーテクノロジー部門 グランプリ）を受賞するなど、エッジ AI の社会実装に向けた開発および拡販活動を進めている。

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【B-1】DX 総論
【B-2】次世代通信